

南亞電路板股份有限公司 2024年營運概況

2025年03月12日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 2025年營運策略



公司概況

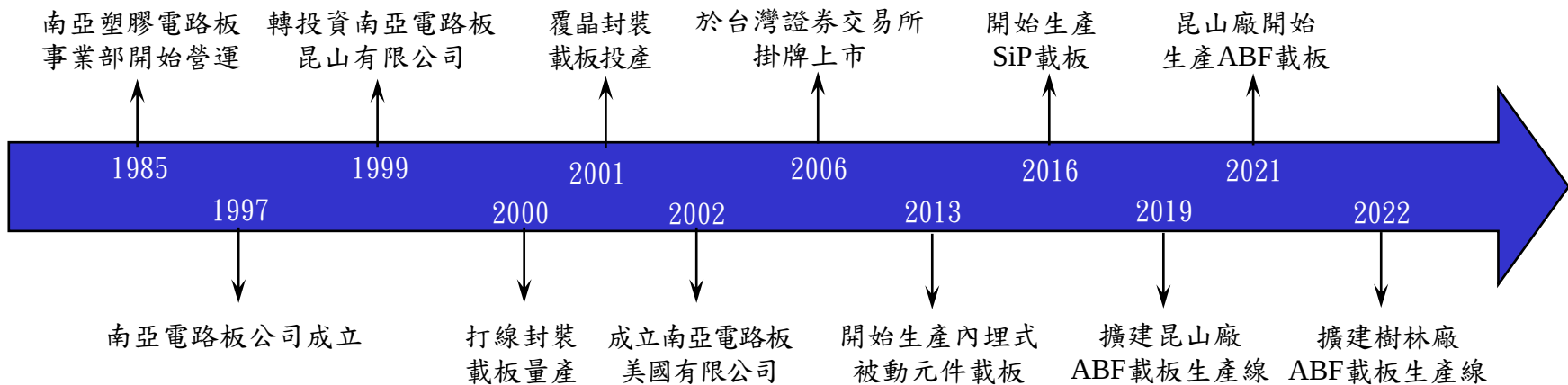
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2024年合併營業額為新台幣 322.8億元。
- 台股上市市值：新台幣822.7億元(2024年12月31日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概况

歷史沿革



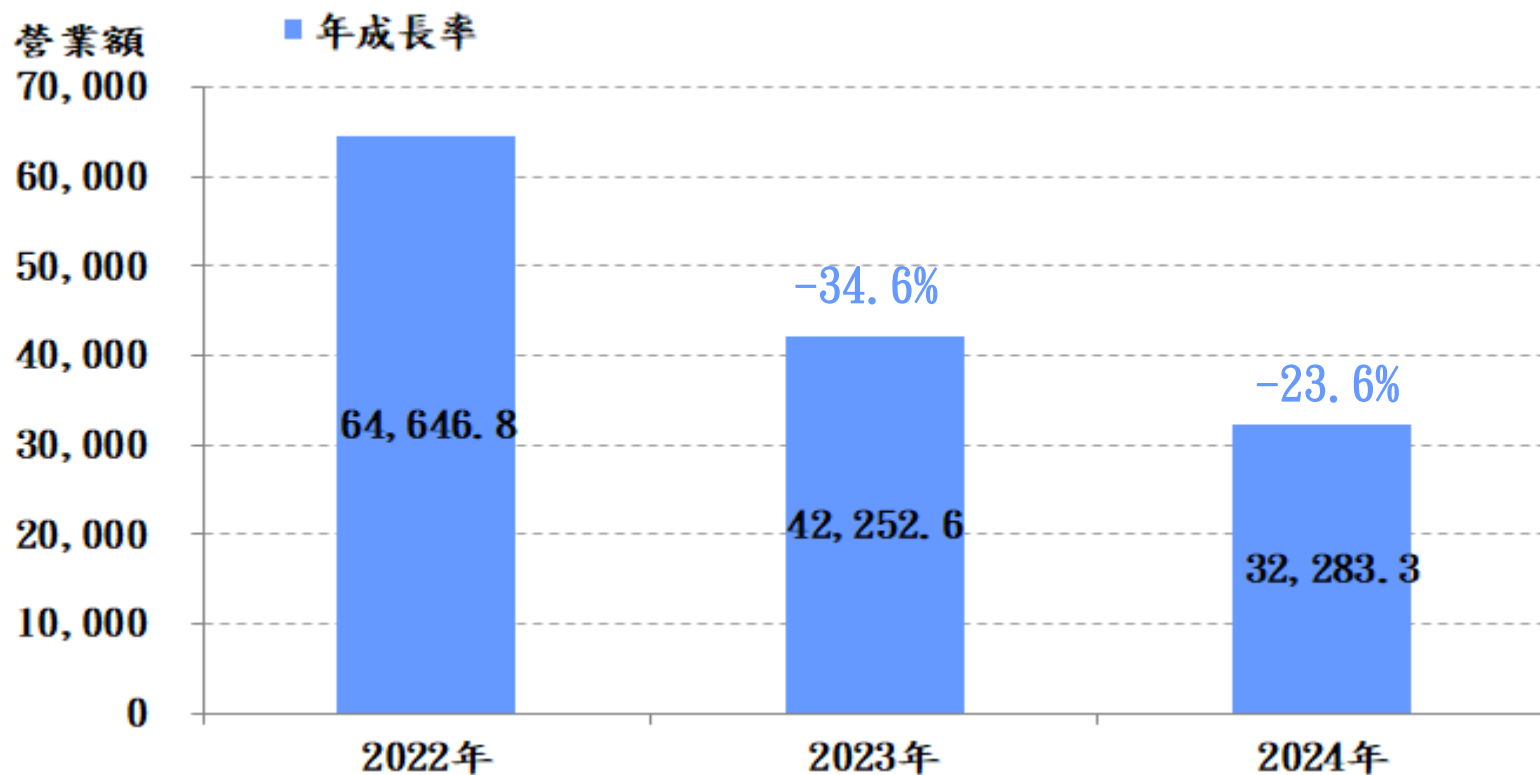
- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板
- 2022 : 樹林廠開始生產ABF載板



財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元



- 2023年營收較2022年減少34.6%:
本公司受消費性電子庫存調整影響，相關應用產品銷售減少，致2023年營收比2022年同期減少。
- 2024年營收較2023年減少23.6%:
網通產品持續庫存調整，2024年營收比2023年下滑。



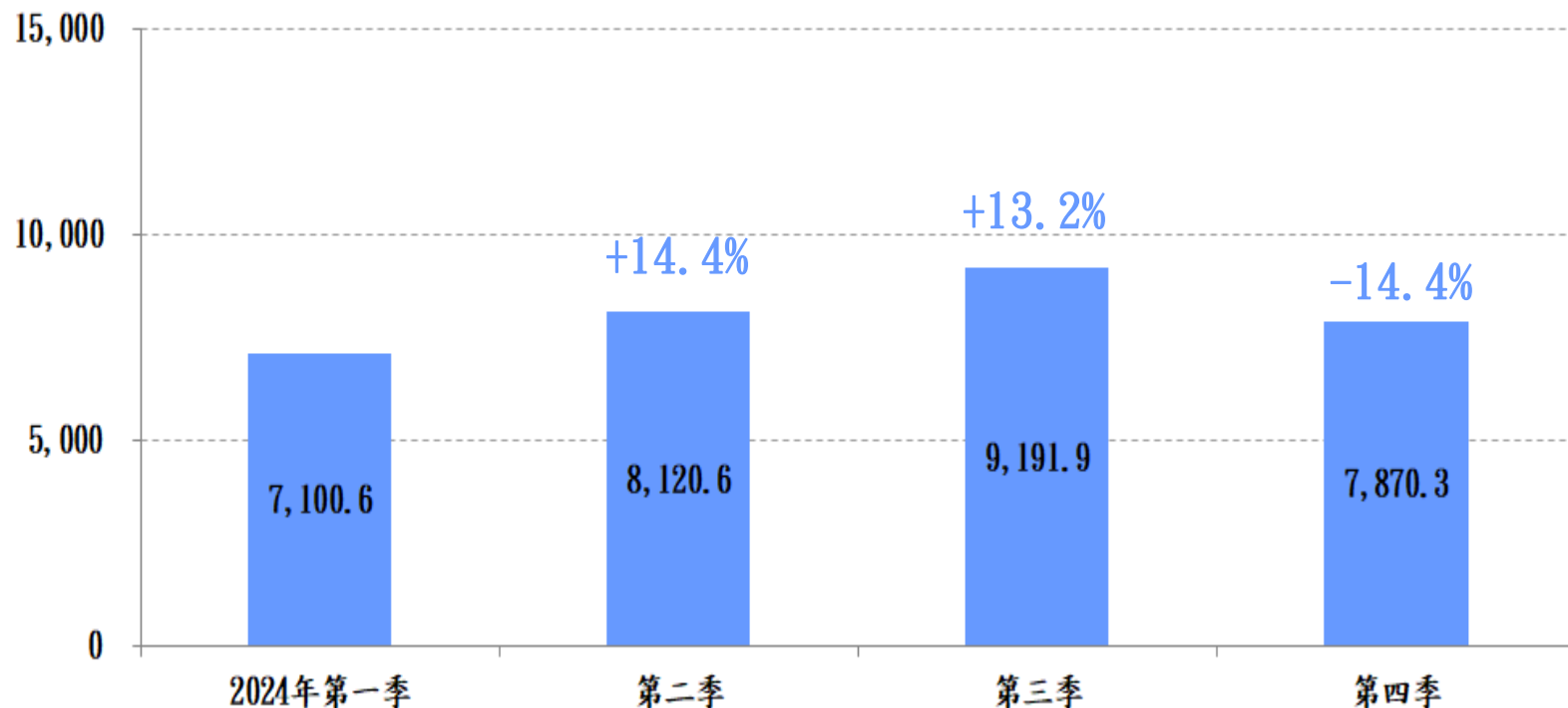
財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

■ 季成長率

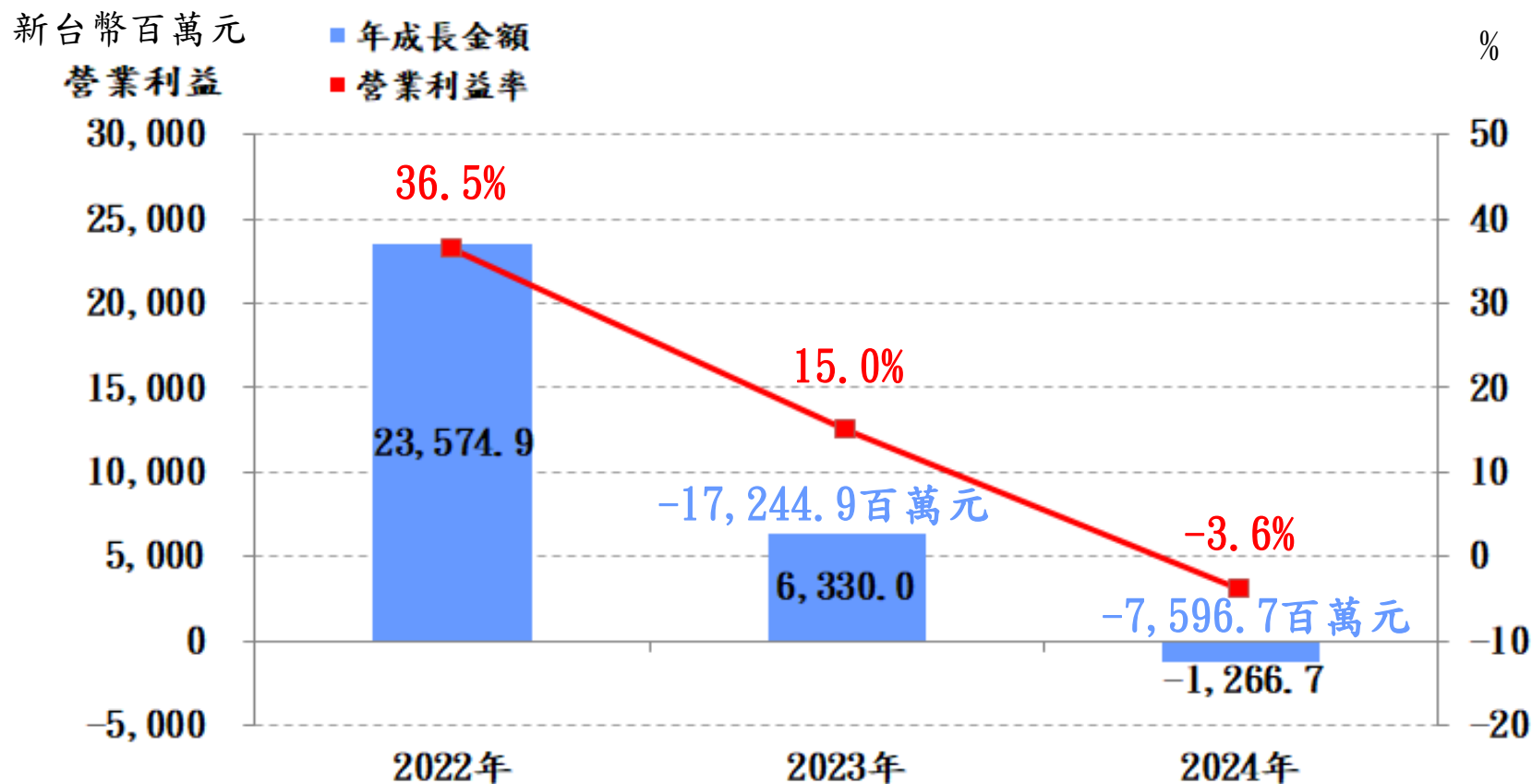


- 2024年第二季營收較2024年第一季增加14.4%:
第二季量產AI PC載板，且記憶體需求回溫，營收比第一季成長。
- 2024年第三季營收較2024年第二季增加13.2%:
第三季量產800G交換器載板等高階產品，營收比第二季成長。
- 2024年第四季營收較2024年第三季減少14.4%:
因消費性電子淡季，PC、遊戲機需求降低，營收比第四季減少。



財務狀況

近三年營業利益

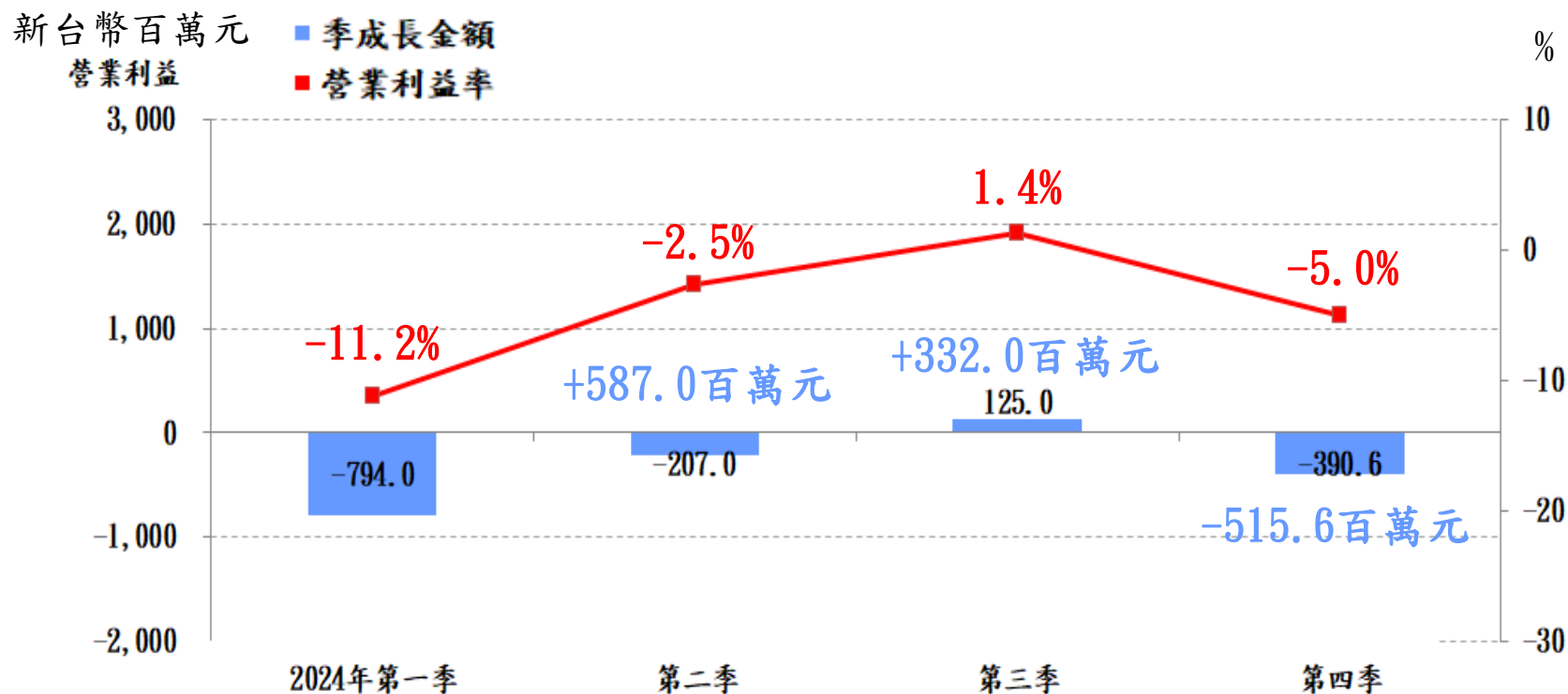


- 2023年營業利益較2022年同期減少17,244.9百萬元：
受消費性電子庫存調整影響，銷售量減少，致營業利益下滑。
- 2024年營業利益較2023年同期減少7,596.7百萬元：
因網通產品需求疲弱，營收規模縮小，致營業利益減少。



財務狀況

近一年每季營業利益

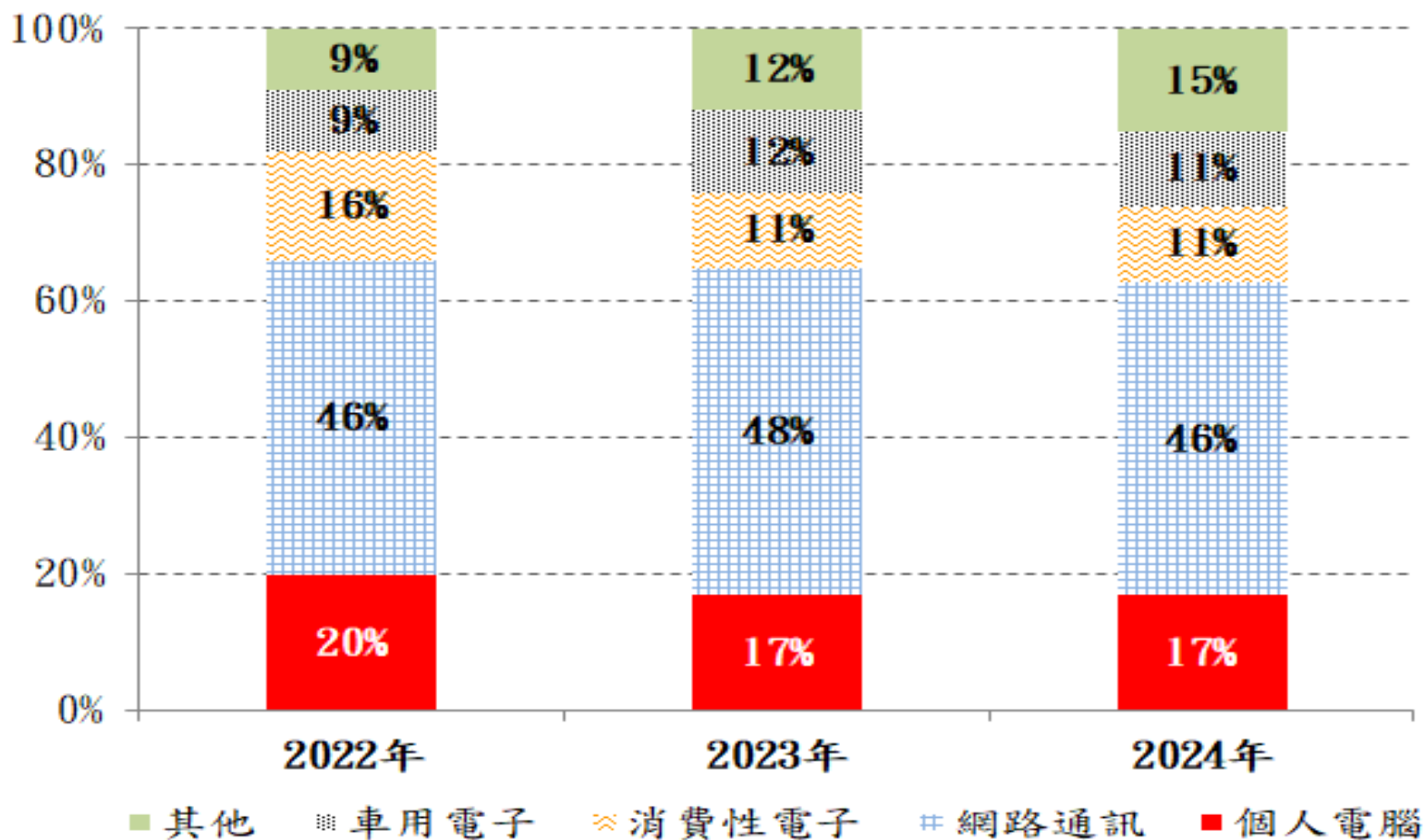


- 2024年第二季營業虧損較2024年第一季減少587.0百萬元：
因AI PC與記憶體需求成長，第二季營收規模增加，致虧損減少。
- 2024年第三季營業利益較2023年第二季增加332.0百萬元：
受益於產品組合好轉，第三季營業利益比前一季增加。
- 2024年第四季營業利益較2024年第三季減少515.6百萬元：
受消費性電子淡季影響，營收規模縮小，第四季營業利益比第三季減少。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

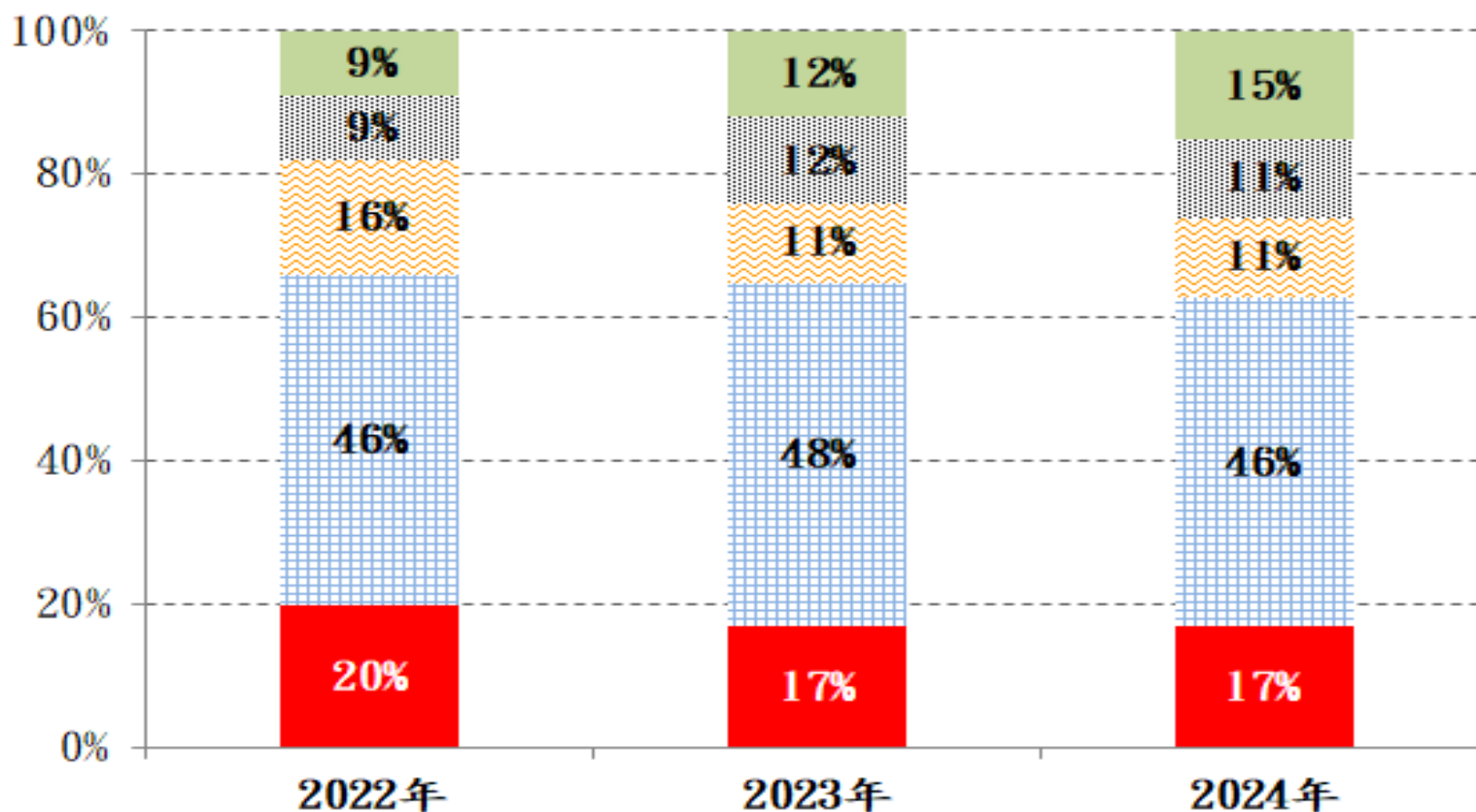


- 個人電腦需求未明顯回溫，2024年相關營收比重持平。
- 受客戶專注發展生成式人工智慧影響，購買網通設備預算減少，致2024年相關營收比重減少。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



■ 其他 ■ 車用電子 ■ 消費性電子 ■ 網路通訊 ■ 個人電腦

- 消費性電子需求未明顯改善，2024年相關營收比重與2023年持平。
- 汽車價格競爭嚴重，供應鏈亦受影響，致2024年營收比重降低。
- 人工智慧與高效運算產品需求相對穩健，2024年營收比重增加。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ ABF載板

將與客戶緊密合作，開發人工智慧(AI)個人電腦(PC)處理器、客製化AI晶片(AI)ASIC、4奈米高階PC繪圖晶片、數據中心處理器、交換器及路由器、WiFi-7網路晶片，以及5奈米ADAS車用處理器等應用載板。

■ BT載板

針對異質晶片封裝發展趨勢，本公司將開發新世代行動裝置的主機板、相機感測器等系統級封裝載板，同時爭取光通訊市場回溫商機，將量產光通訊晶片、5G光通訊收發模組等應用載板，以及切入衛星通訊領域，量產低軌衛星接受器應用產品。

■ 一般電路板

資料中心伺服器帶動HDI與多層板需求，本公司將開發並量產AI伺服器加速卡、新世代伺服器網通卡、伺服器固態硬碟，以及電源模組等應用產品，並持續開發與認證高階伺服器高頻材料產品，擴大資料中心應用產品比重，以改善產品組合。



2025年營運策略

公司執行四大轉型以提升競爭力

- 產品轉型：提升高值化、差異化產品比重，拓展新應用及市場。
- 事業轉型：開發新材料、新技術及新產品，深化公司產業佈局。
- 數位轉型：應用數位科技，精進AI及數位轉型，實現智能化營運。
- 低碳轉型：擴大綠電使用，致力節能減碳，落實循環經濟推動。



感謝您的聆聽

